



**平成24年3月期  
(第10期)  
第2四半期決算説明会**

**平成23年11月4日  
株式会社ジーダット**

# 平成24年3月期第2四半期決算のポイント

**上半期計画比 売上高、利益ともほぼ計画通り**

**市場別売上高 半導体:  $\Delta 3.0\%$ 、FPD:  $+10.3\%$**

**上半期前年同期比 売上高:  $\Delta 6.7\%$ 、利益: 赤字転**

**市場別売上高 半導体:  $\Delta 11.8\%$ 、FPD:  $\pm 0\%$**

**上期研究開発投資及び製品開発はほぼ計画通り**

**計画外本社移転により固定費は対計画、対前年で増加**

# 上半期実績 -前年同期比・計画比-

(単位:百万円)

	平成23年 3月期実績	平成24年3月期			
		計画	実績	前年 同期比	計画比
売上高	726	660	678	△6.7%	2.8%
売上総利益	527	460	490	△7.0%	6.5%
販売費及び 一般管理費	496	503	529	6.6%	5.2%
営業利益	31	△42	△38	—	—
経常利益	40	△19	△24	—	—
四半期 純利益	24	△14	△14	—	—

# 通期予想 -前年同期比-

(単位:百万円)

	平成23年 3月期実績	平成24年3月期		
		当初計画	通期予想	前年同期比
売上高	1,434	1,400	1,400	△2.4%
売上総利益	1,006	989	1,015	0.9%
販売費及び 一般管理費	1,021	1,019	1,045	2.3%
営業利益	△14	△30	△30	—
経常利益	37	20	20	△47.3%
当期純利益	15	5	5	△61.0%

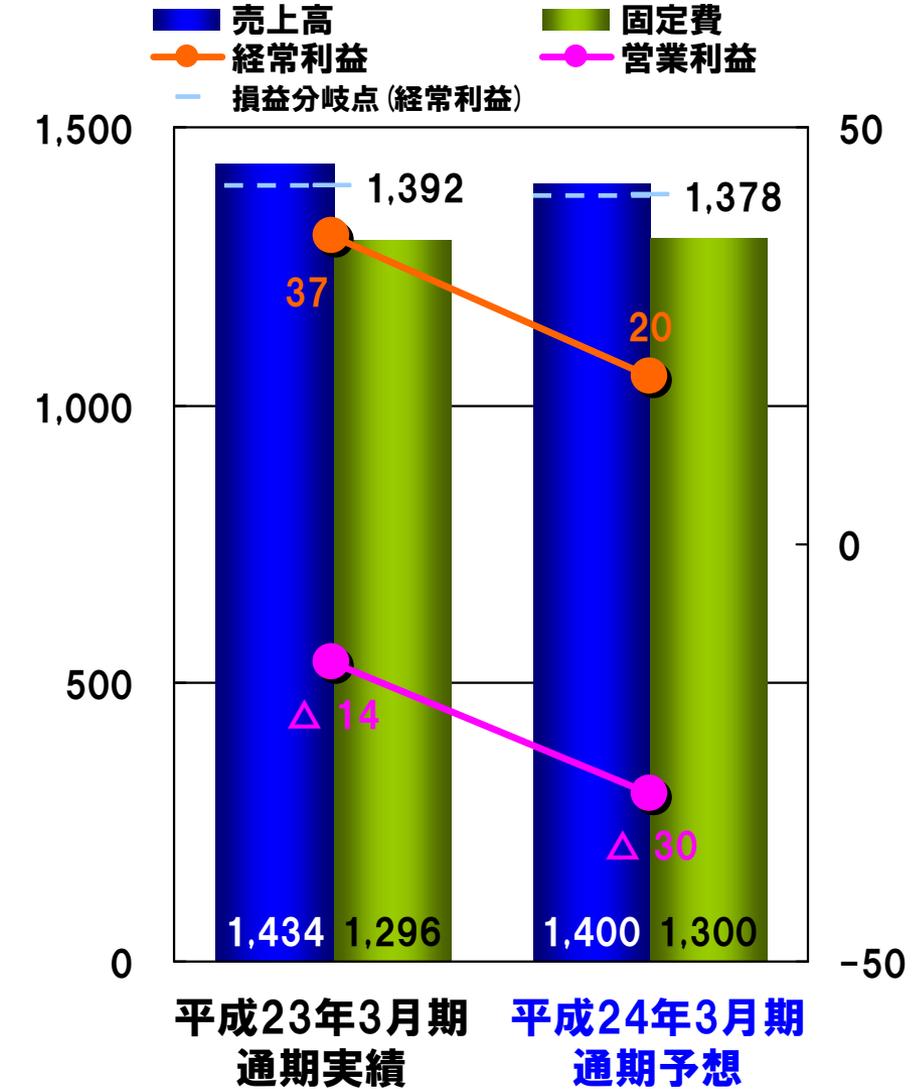
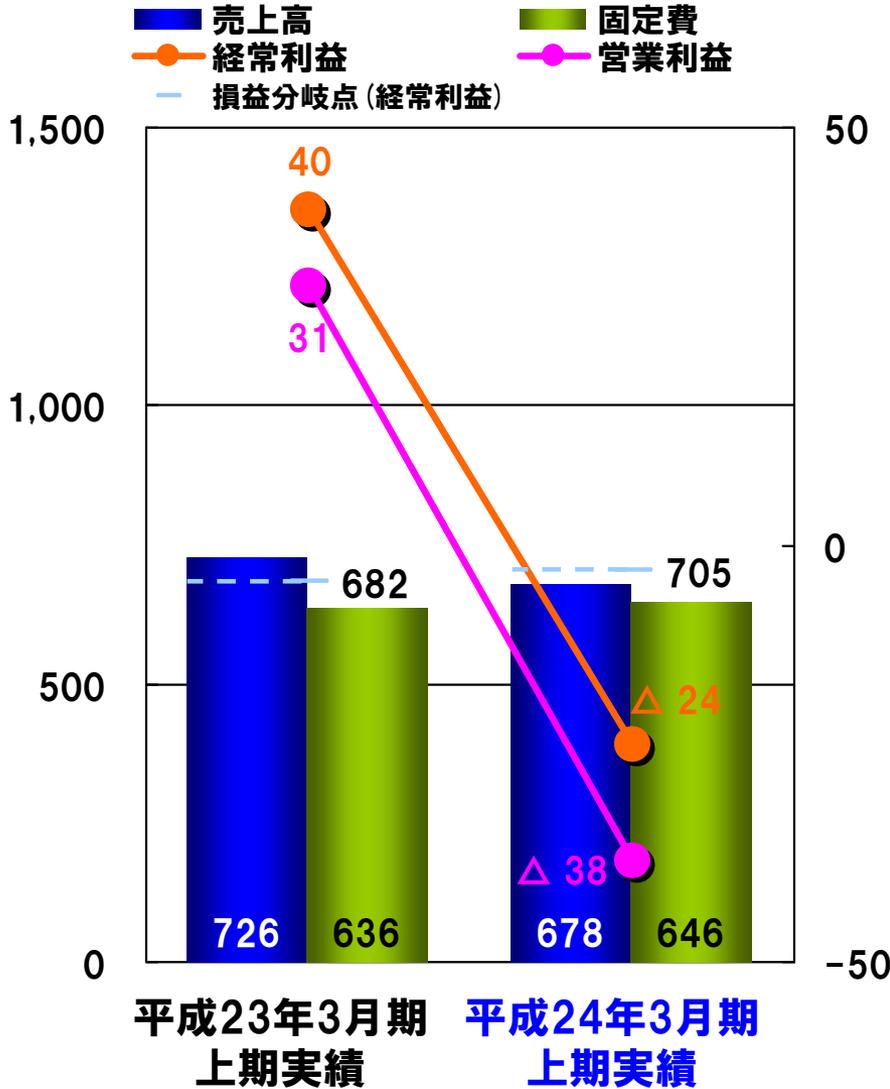
# 売上高・利益 - 前年同期比 -

【上期】

(単位:百万円)

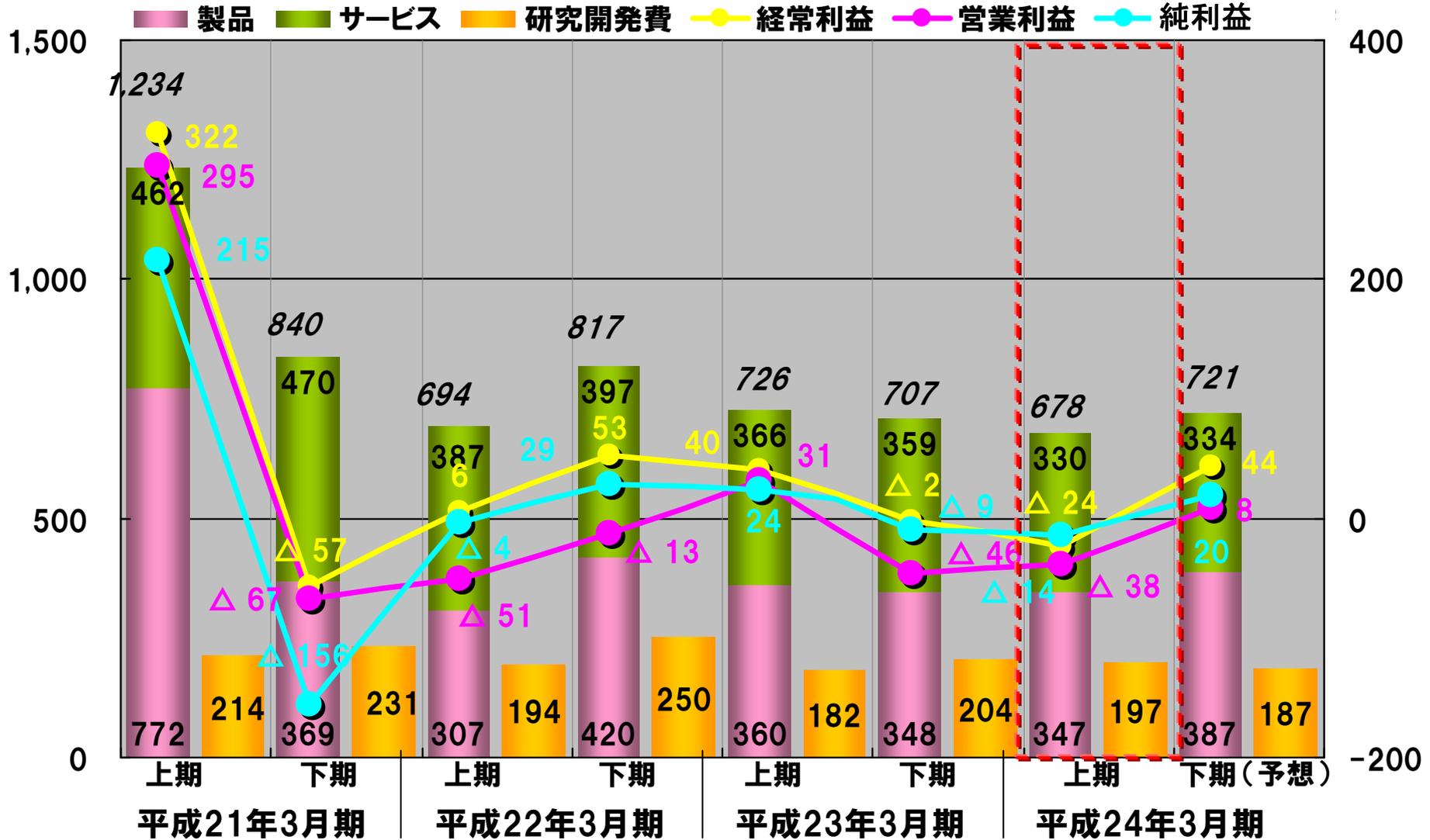
【通期】

(単位:百万円)



# 半期毎売上高・利益の推移

(単位:百万円)



# 連結貸借対照表 - 前期末比 -

(単位:百万円)

	平成23年 3月期末	平成23年 9月30日	差異		平成23年 3月期末	平成23年 9月30日	差異
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>	2,353	2,503	150	<b>I 流動負債</b>	224	355	130
1 現金及び預金	2,054	2,109	55	1 買掛金	34	58	23
2 受取手形及び売掛金	214	247	32	2 未払法人税等	8	6	△2
3 たな卸資産	7	5	△1	3 賞与引当金	40	48	7
4 繰延税金資産	20	53	32	4 その他	141	243	102
5 その他	56	88	32	<b>負債合計</b>	224	355	130
<b>II 固定資産</b>	298	242	△55	<b>(純資産の部)</b>			
1 有形固定資産	29	18	△11	<b>I 株主資本</b>	2,432	2,396	△35
2 無形固定資産	22	22	0	1 資本金	760	760	-
3 投資その他の資産合計	246	201	△45	2 資本剰余金	890	890	-
繰延税金資産	193	174	△18	3 利益剰余金	814	778	△35
その他	53	26	△27	4 自己株式	△32	△32	-
				<b>II 評価・換算差額等</b>	△4	△5	△1
				その他有価証券評価差額金	-	-	-
				為替換算調整勘定	△4	△5	△1
				<b>純資産合計</b>	2,427	2,390	△36
<b>資産合計</b>	2,652	2,746	94	<b>負債純資産合計</b>	2,652	2,746	94

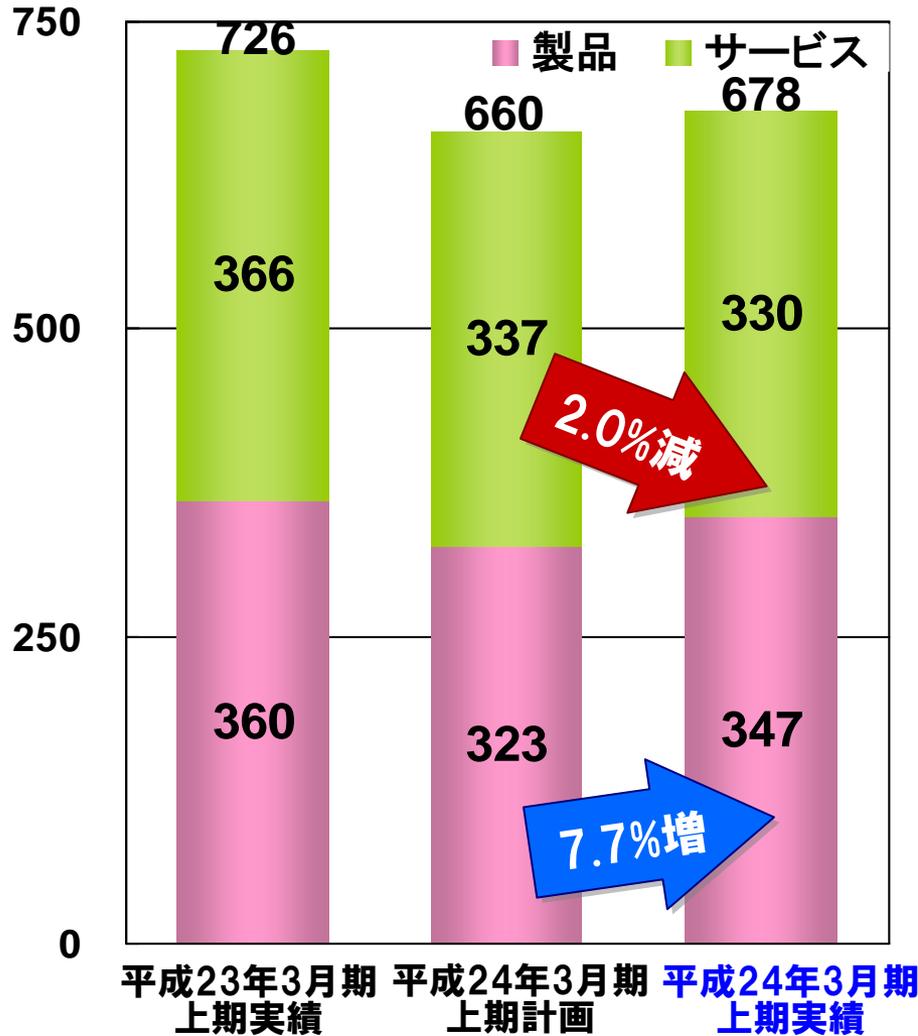
# 連結キャッシュフロー計算書 - 前年同期比 -

(単位:百万円)

	平成22年4月1日 ～ 平成22年9月30日	平成23年4月1日 ～ 平成23年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	243	92	△ 150
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△411	281	693
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△19	△ 19	-
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△ 2	△ 1
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	△188	352	540
VI 現金及び現金同等物の期首残高	981	854	△ 127
VII 現金及び現金同等物の期末残高	792	1,209	416

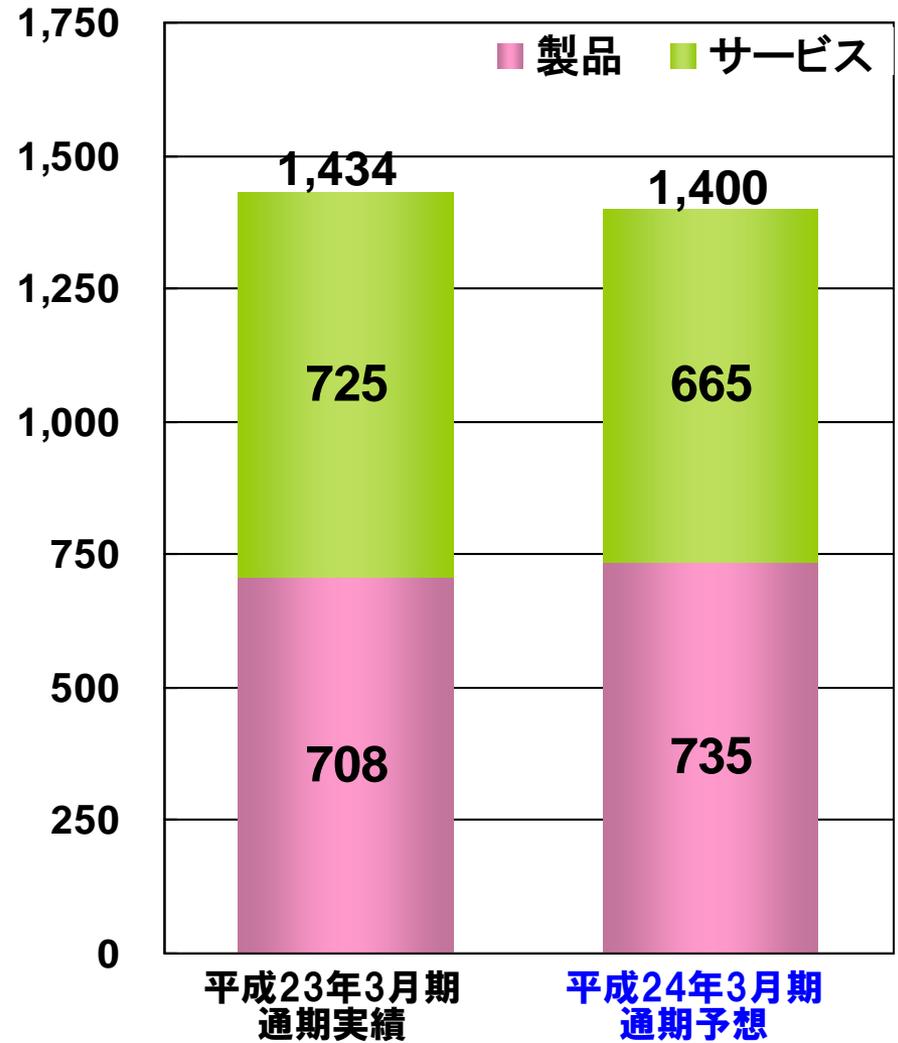
# 事業別売上高（製品/サービス） -計画比-

## 【上期】



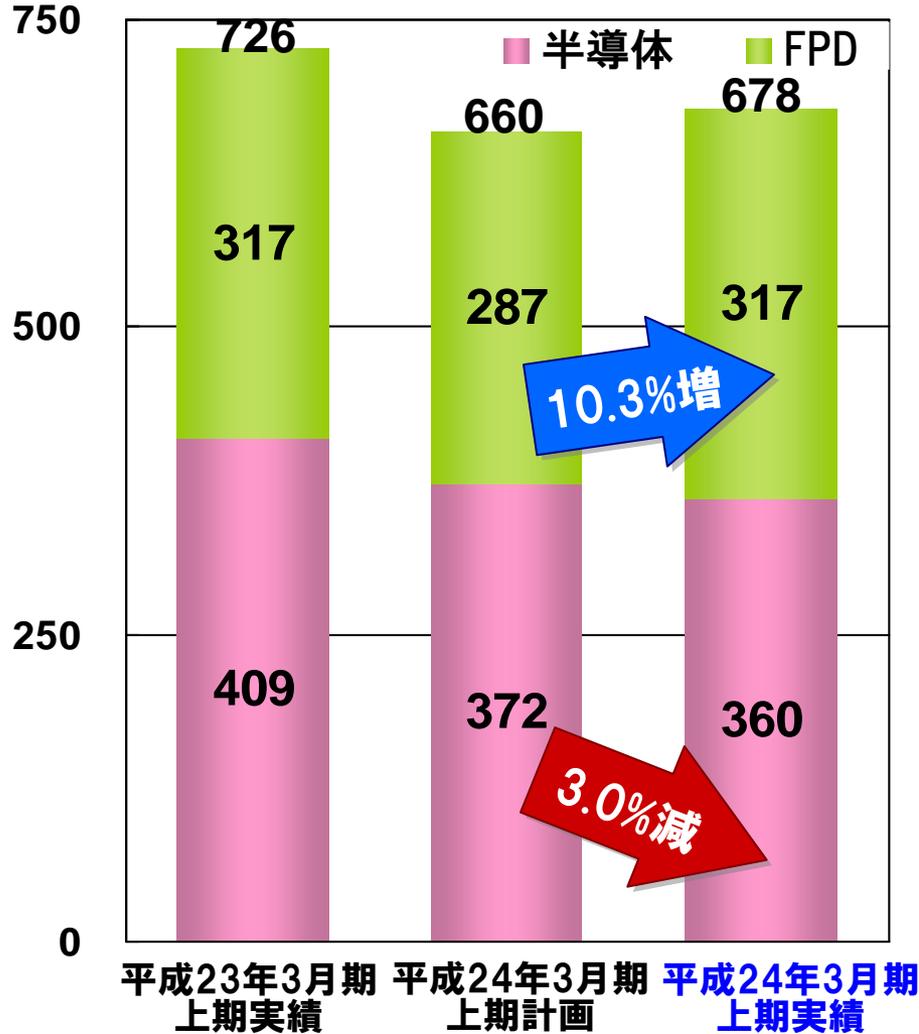
## 【通期】

(単位:百万円)



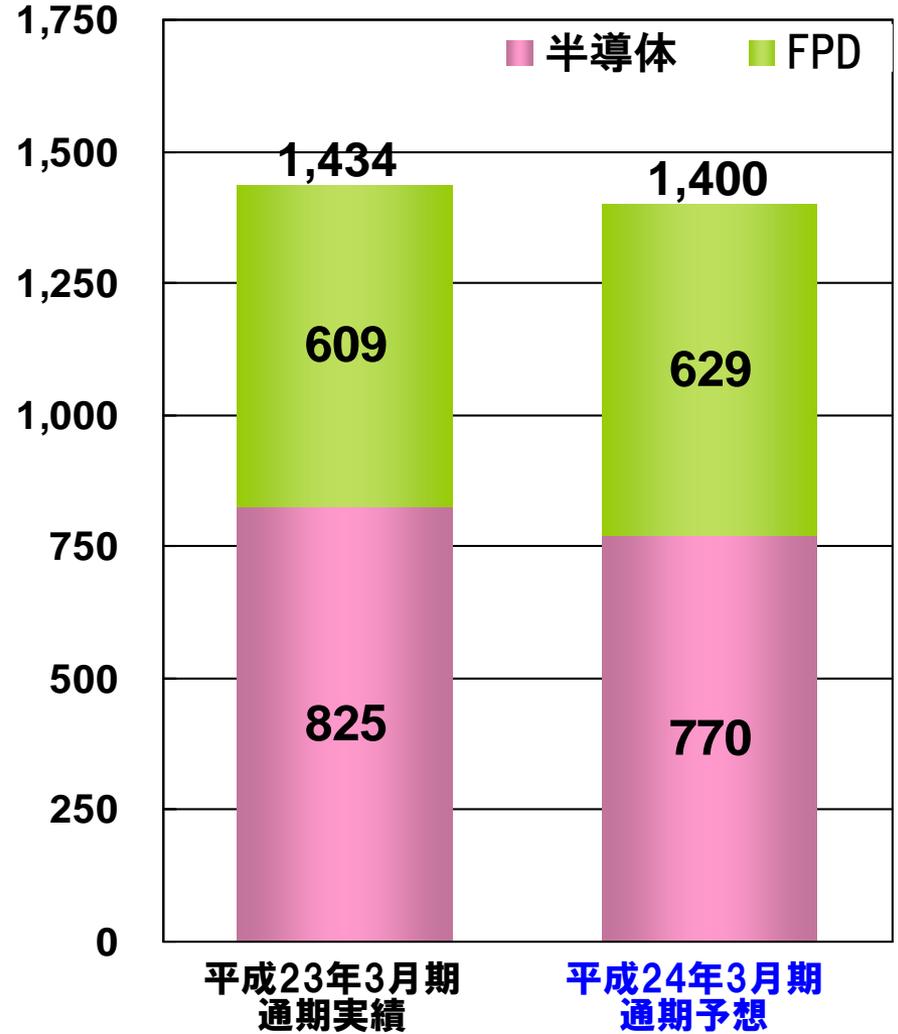
# 市場別売上高 (半導体/FPD) -計画比-

## 【上期】



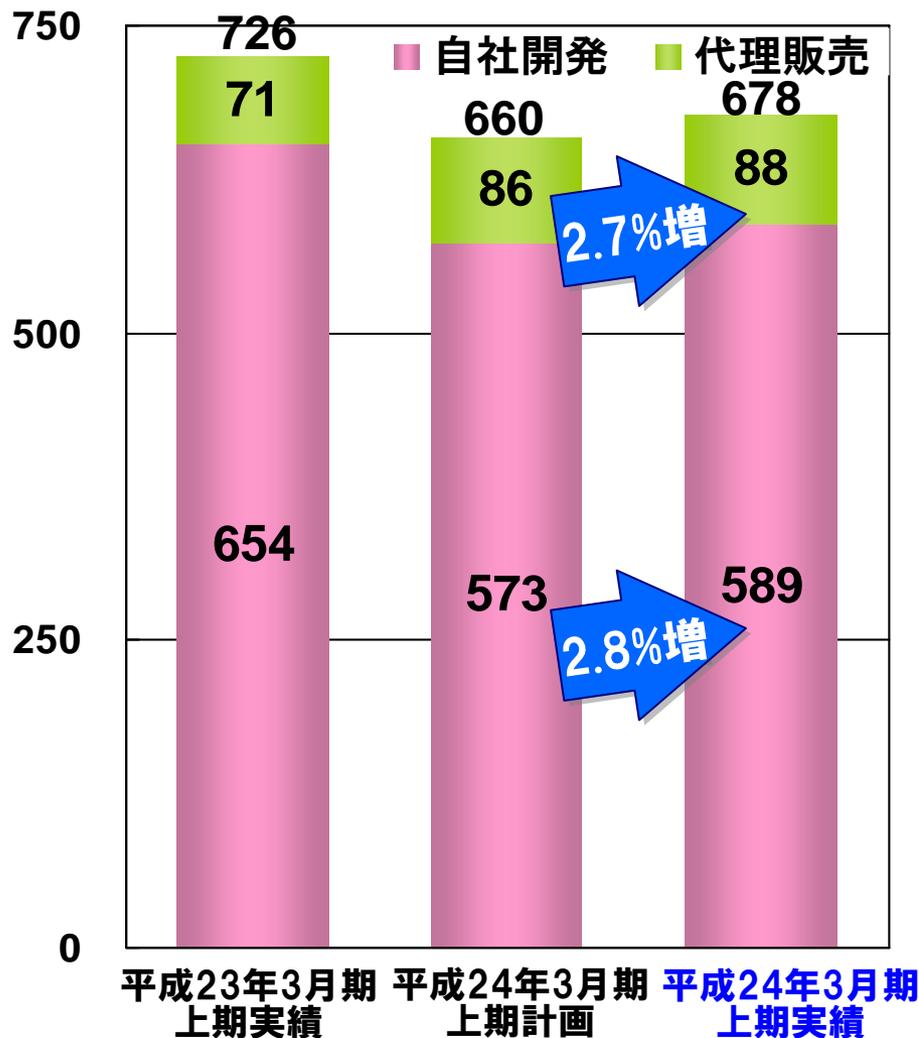
## 【通期】

(単位:百万円)



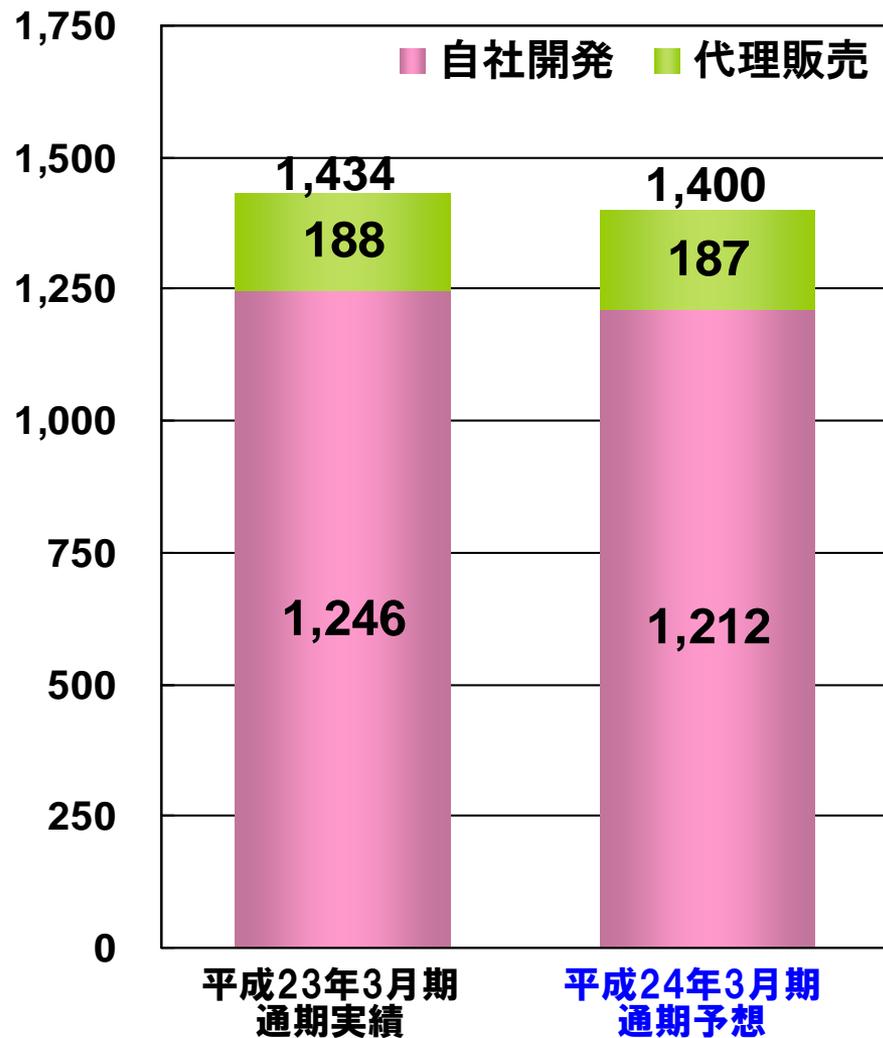
# 製品区分別売上高（自社開発／代理販売）-計画比-

## 【上期】



## 【通期】

(単位:百万円)



# 固定費内訳 - 計画比 -

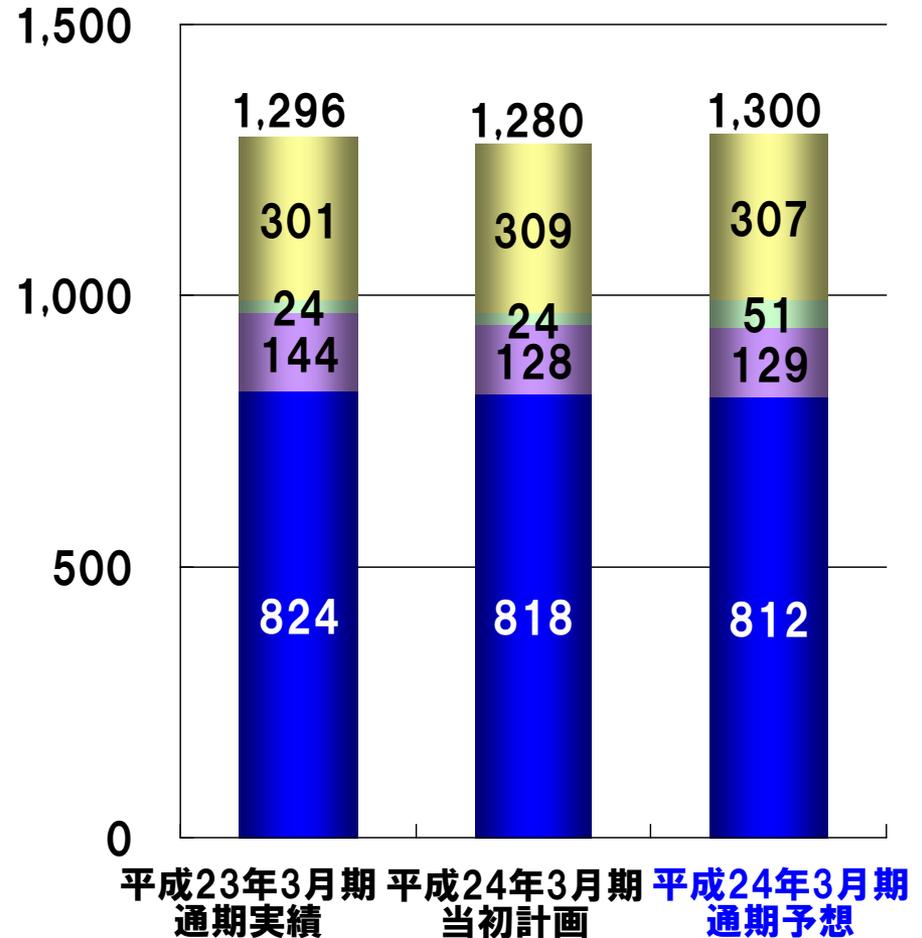
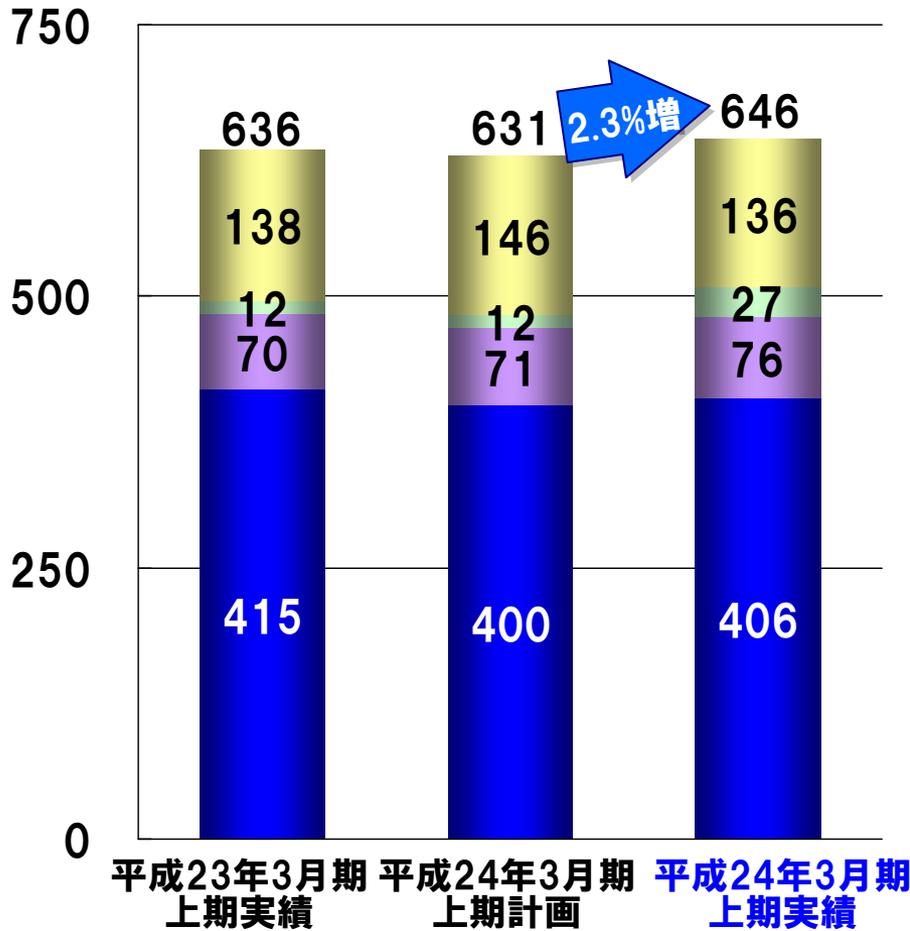
## 【上期】

## 【通期】

(単位:百万円)

■ 人件費      ■ 外注費  
■ 減価償却・のれん償却費   ■ その他経費

■ 人件費      ■ 外注費  
■ 減価償却・のれん償却費   ■ その他経費

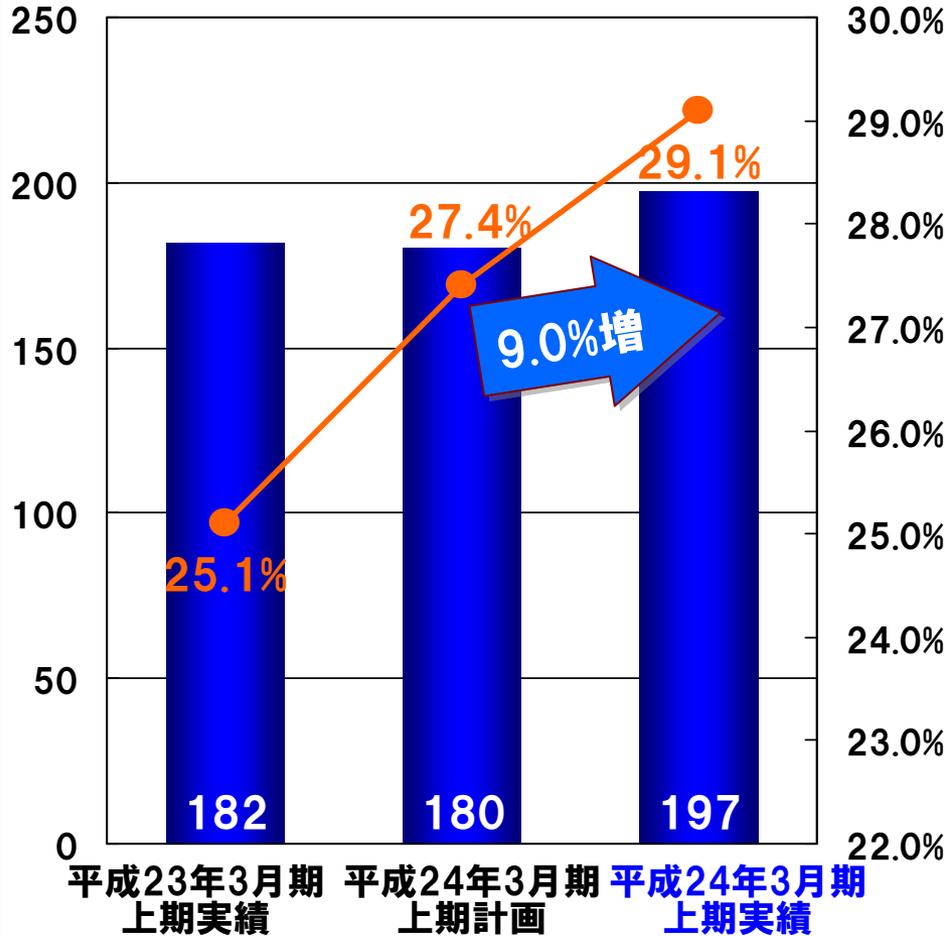


# 研究開発費 - 計画比 -

(単位:百万円)

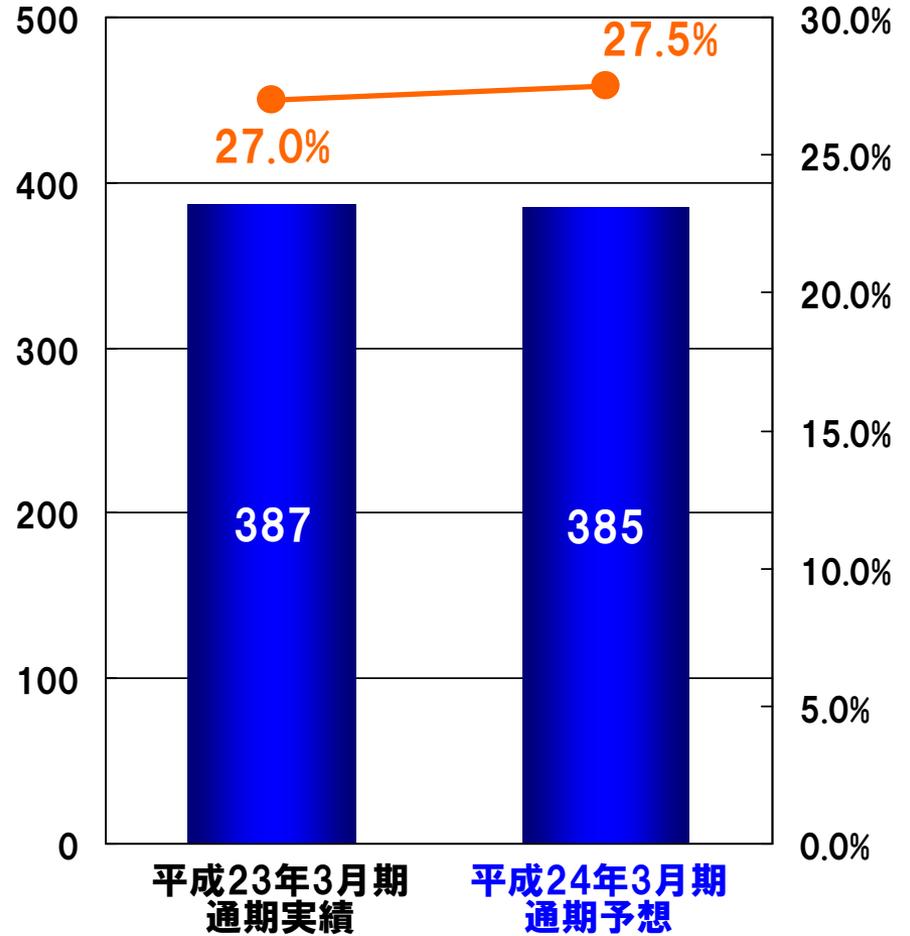
## 【上期】

■ 研究開発費 ● 売上高比



## 【通期】

■ 研究開発費 ● 売上高比



# 上半期国内概観

## ➤ 東日本大震災の影響はあったものの、リーマン危機以降の回復基調は緩やかに継続？

- 装置、材料、電子部品……
- しかし、半導体、FPDとも活気がない

続く  
国内市場  
縮小傾向

## ➤ 長期化する超円高

- 半導体各社: 製造アウトソーシング シフト 台湾、韓国…
- LCDパネル: モバイル シフト ジャパンD、シャープ亀山…

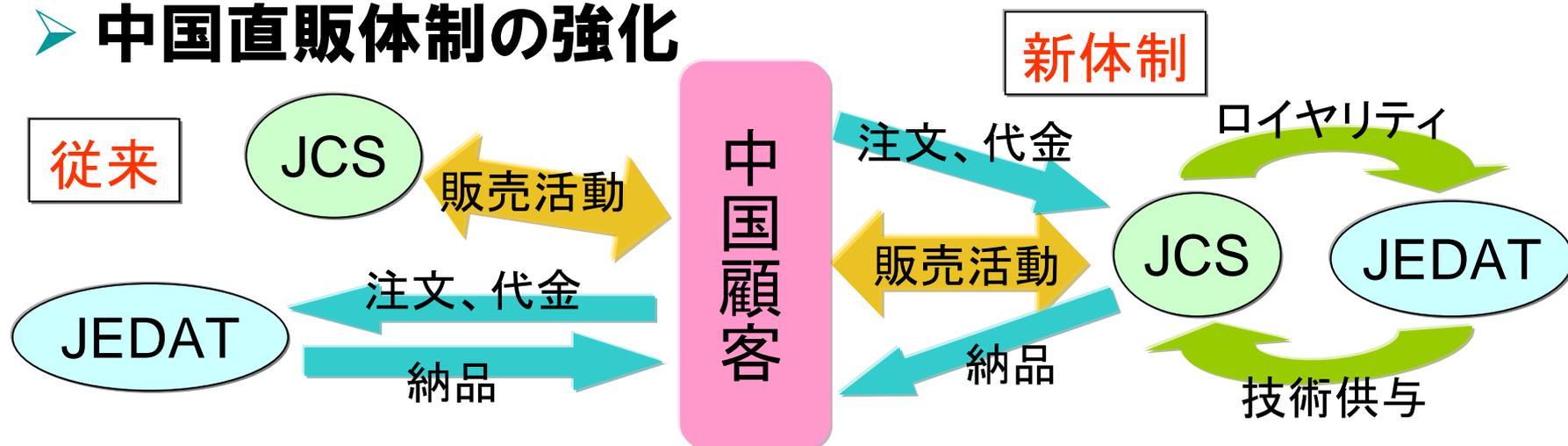
## ➤ 新興国市場の拡大…構造的な過当競争

- LCDパネル トップ4:3四半期連続赤字
- 家電各社 TV事業縮小

続く  
価格低下

# 主なトピックス

## 中国直販体制の強化



## 超高速 図形演算・パターンマッチング ツール:

**HOTCHECK**発表(10月) **新製品**

ホットスポット検索等に大きな効果!

## FPD向け超高速DRC: **Hayato**発表(10月) **新製品**

## プライベートフェア開催(10月) 東京、大阪

- 4件のユーザ事例、TSMC講演が大好評

# 下半期の拡販策

- **半導体：電源解析ツールPowerVoltの拡販**
  - 今、十分に製品競争力がある
  - 省エネ、高信頼性に貢献：時代の要請に合致
- **半導体：海外ファウンドリPDKのサポート強化**
  - 超円高による製造の海外委託増加に対応
- **FPD：特に拡大する中国市場での拡販**
  - 高精度抵抗計算・容量計算ツールの販促強化
  - FPD向け高速DRC・Hayatoの早期市場投入：11月
  - カスタムソフトウェア開発サービスの拡充

新製品

# 中国FPD市場の特性

- **金に飽かした荒っぽい企画？**
  - 補助金バブル？
  - BOE:2013年から内モンゴルで有機ELパネル量  
スマートフォン向け、月産2.4万枚、(2011.10.)
- **設計者不足、今後さらに1000人？**
  - 地方都市の過当競争
  - 新卒新人が戦力:まず市販品をばらしてコピー  
早くも自立設計、性能、品質にこだわらずコスト
  - EDAツールに設計マニュアルを期待
  - 海外技術者流入、From日本→韓国→台湾
- **急速な技術の習得と製品化**

今、シェアを取っておく  
必要がある！

# JEDAT製品開発の新たなチャレンジ

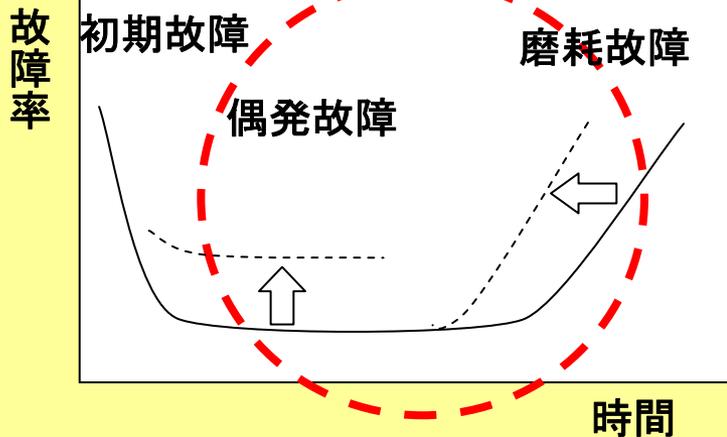
## 設計生産性の革新

- 回路Sim制御・解析の自動化
- フロアプランの高精度高速化
- レイアウトの自動化
- 実用的な再利用機構

STARC  
認証

+

## 高信頼性設計



EM  
ESD  
TDDDB  
HCI  
SM  
⋮  
⋮

標準化対応強化:  
OA、iPDK、OpenPDK

ポイントツール販売  
\* 強力な自動ツール、  
検証ツールが  
他社環境上でも稼動

\* EM/IRdrop解析  
PowerVoltの拡張  
\* 制約検証の拡張

海外展開強化

## 参考:半導体の故障例

- EM: Electromigration
  - 電流密度増大による断線
- ESD: Electrostatic Discharge
  - 静電気破壊
- TDDDB: Time Dependent Dielectric Breakdown
  - 経時的絶縁破壊
- HCI: Hot-Carrier Instability
  - ホットキャリア不安定化による特性劣化
- SM: Stressmigration
  - 熱的、機械的な応力による断線

# 高信頼性設計：次世代高信頼性LSI設計技術開発へのチャレンジ

背景

- 半導体は電子機器に組み込まれて、電流、熱、応力など様々な負荷にさらされ続ける――>経時的な故障発生
- 故障率低減のために製造上の多くの工夫がなされているが、
- 設計段階でもっとやれることがあるのではないか

## テーマ「次世代高信頼性LSI設計技術開発」

**NEDO**「研究開発型ベンチャー技術開発助成事業」に採択

期間 H23/9月～H25/2月

共同研究 大阪大学／中前研究室、弘前大学／黒川研究室

### 課題：

- ・故障要因/パラメータの種類が多い
- ・各故障のモデル化
- ・実用的な検証時間

### 研究・開発内容：

- ・デバイス統合モデルの研究
- ・設計向け高速解析モデルの開発
- ・検証ツールの研究、開発

**Goal:**様々な故障要因を統一的に解析し、効率的な高信頼性設計を実現

# 事業継続性の強化(BCP)

## 想定災害

東京直下型地震  
東海・南西地震  
台風・高潮  
集中豪雨・洪水  
火事 等々

## 発生事象

建物崩壊・機器破損  
停電・断水  
交通・道路不通  
通信不通  
浸水・火災

## 重要課題

重要IP・情報  
資産の保全

業務遂行機器  
の保全

社員  
の安全確保

業務再立上げ  
の早期化

## 事前対策強化

東京/北九州/北京間  
相互バックアップ

外部サーバーの活用

緊急用品備蓄

在宅勤務

本社移転 11月28日  
R&D : 1F→6F  
営業他: 2F→3F

# ご清聴 ありがとうございました

弊社は下記に本社を移転します。

新住所：東京都中央区東日本橋3-4-14

電話番号は変わりません。

移転日： 11月26,27日

営業開始日：11月28日(月)

これからもどうかよろしくお願い致します。